

Добро пожаловать в O-Leading

O-Leading стремится быть вашим универсальным партнером по решениям в цепочке поставок EMS, включая проектирование печатных плат, изготовление печатных плат и сборку печатных плат (PCBA). Мы предлагаем одни из самых передовых технологий печатных плат, включая печатные платы HDI, многослойные печатные платы, жесткие-гибкие печатные платы. Мы можем поддерживать от быстрого прототипа до среднего и массового производства.

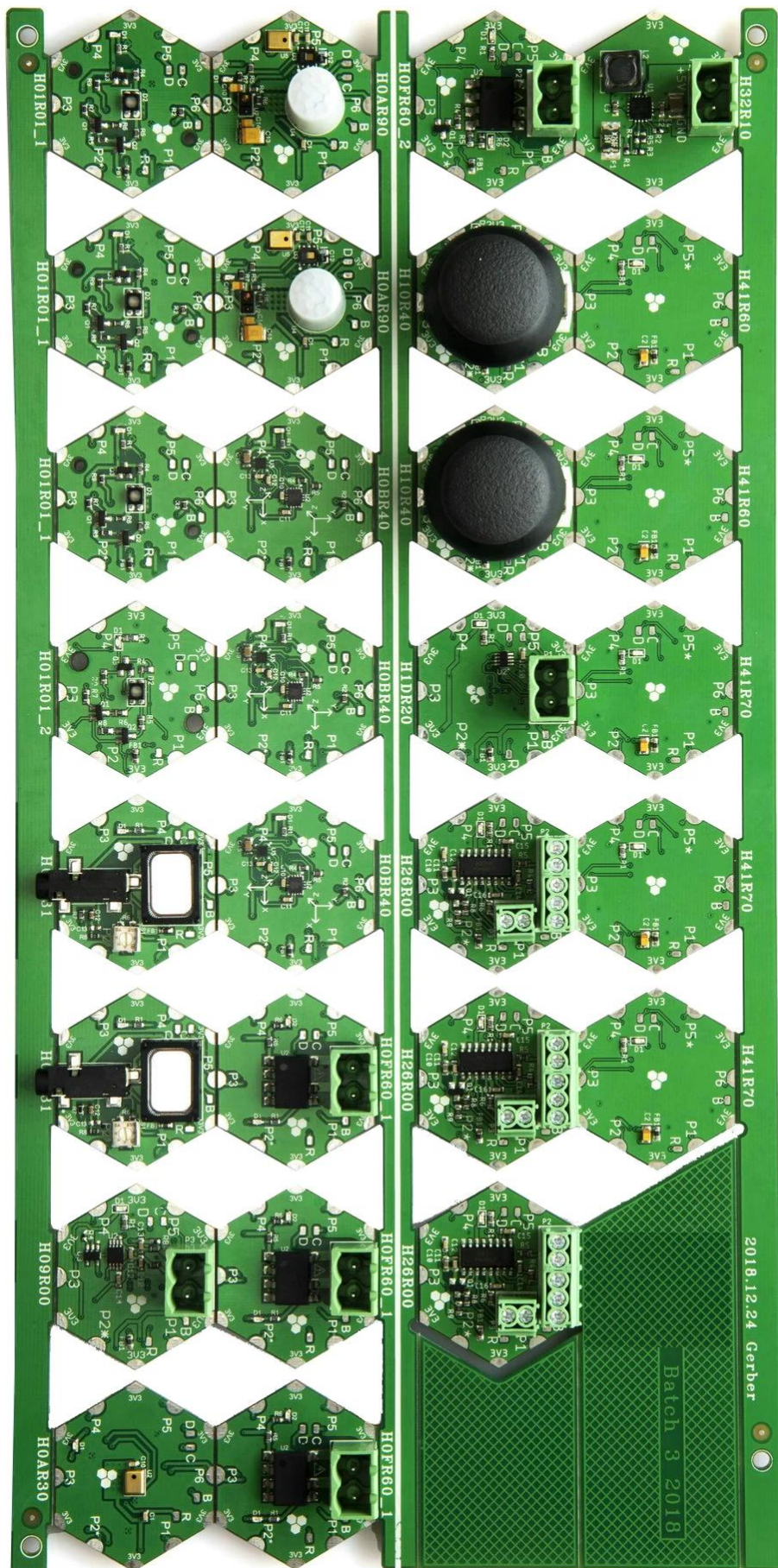
В целом наши глобальные клиенты очень впечатлены нашими услугами: быстрое реагирование, конкурентоспособные цены и приверженность качеству. Предоставление более ценных технических услуг и комплексных решений - это путь вперед.

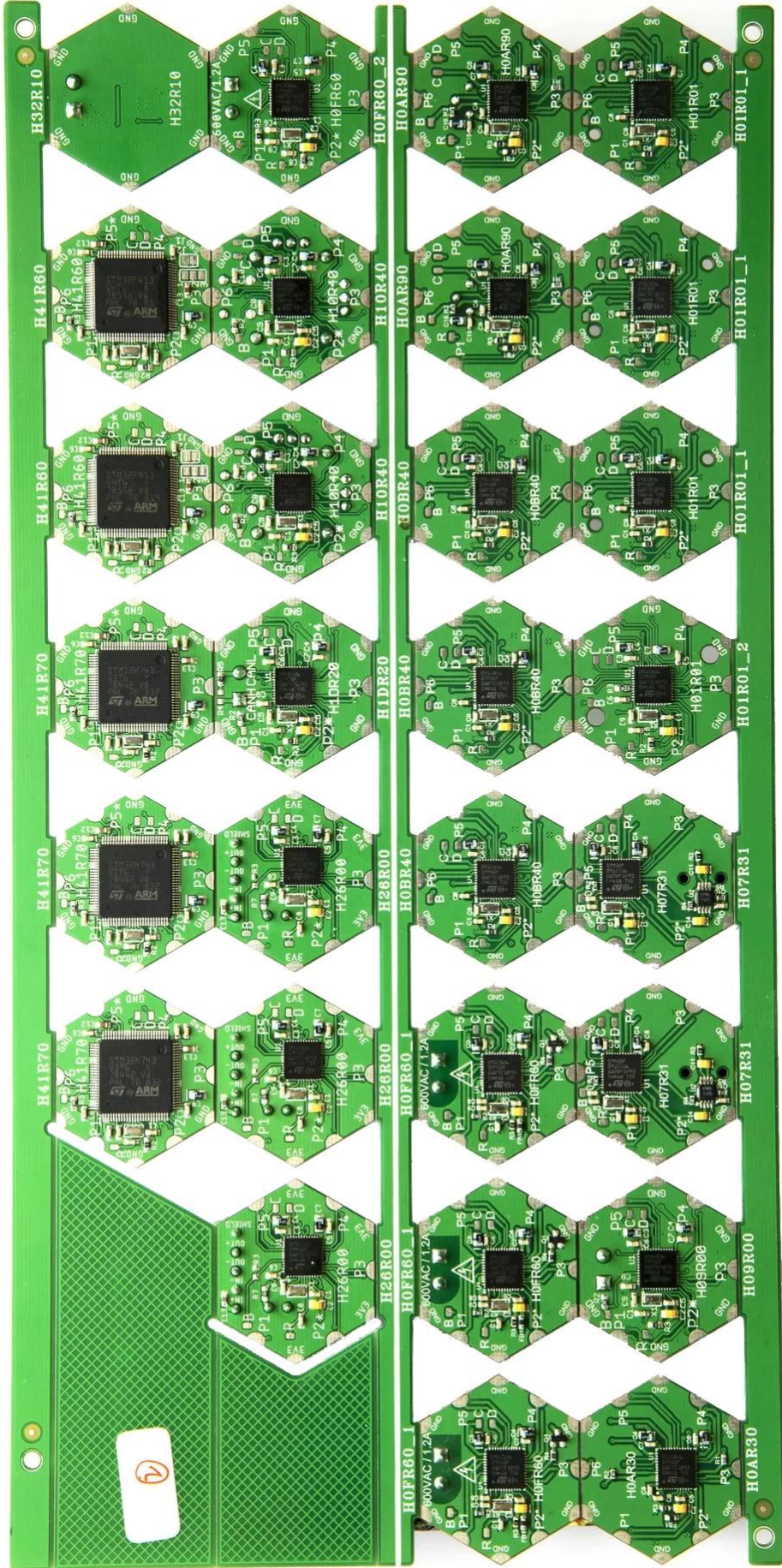
Заглядывая в будущее, O-Leading, как всегда, будет концентрироваться на инновациях и развитии технологий производства электроники и прилагать постоянные усилия для универсального обслуживания печатных плат и печатных плат, чтобы предоставлять первоклассные услуги и создавать большую ценность для наших клиентов.

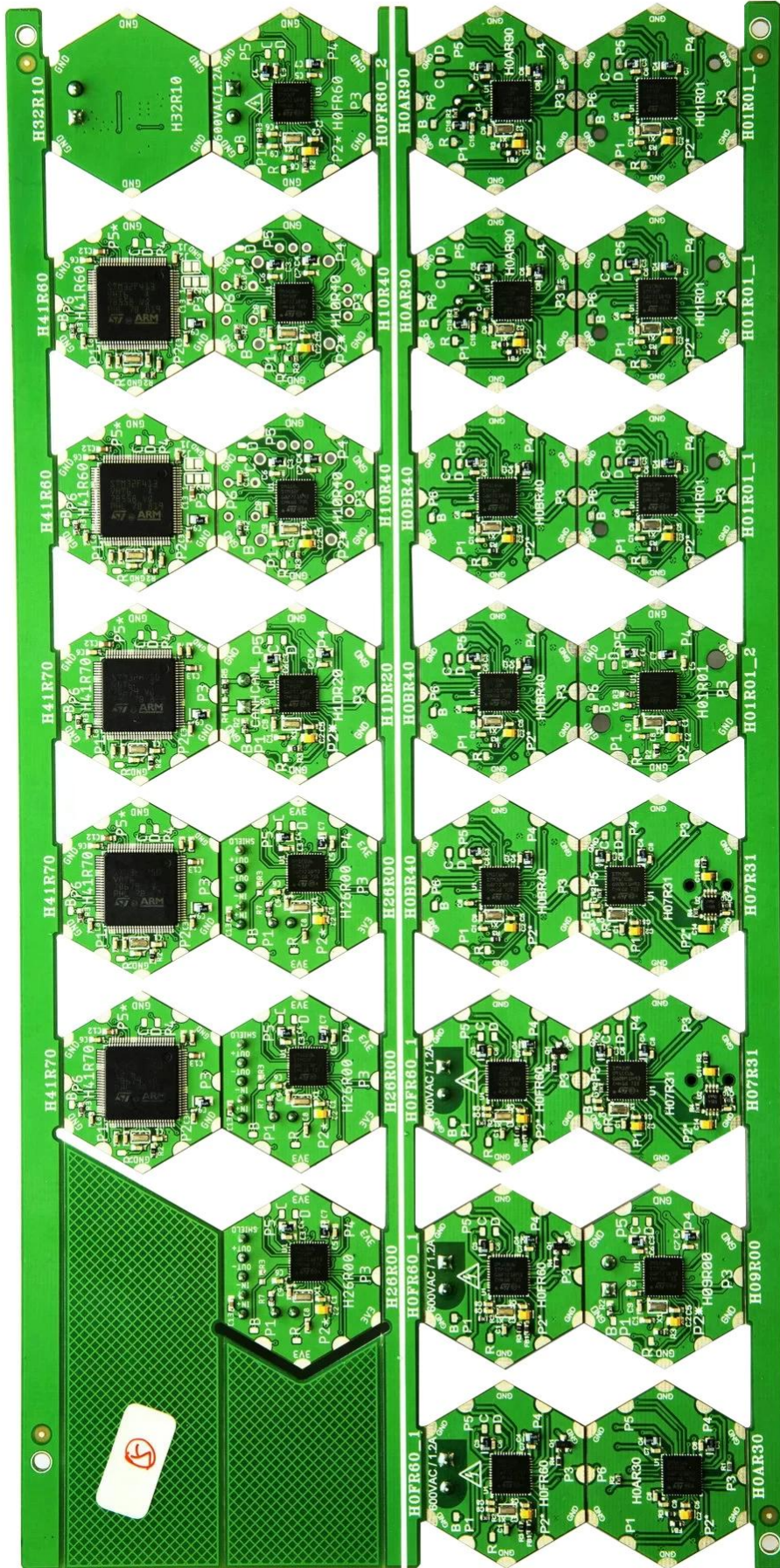
ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ НА ЭТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

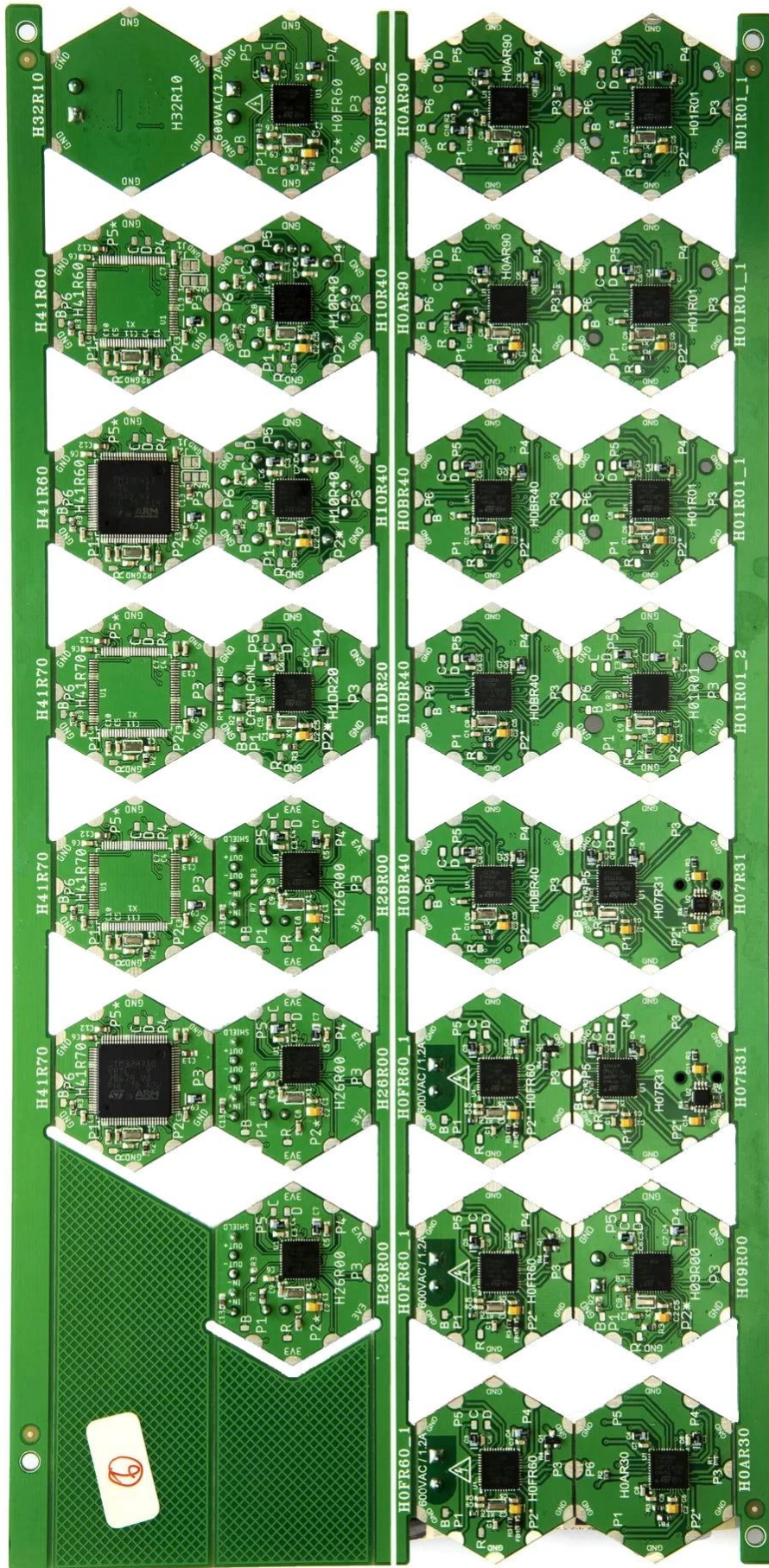
[▢ Индивидуальный одноплатный интерфейсный модуль Raspberry Pi 3B и 3B 4B](#)

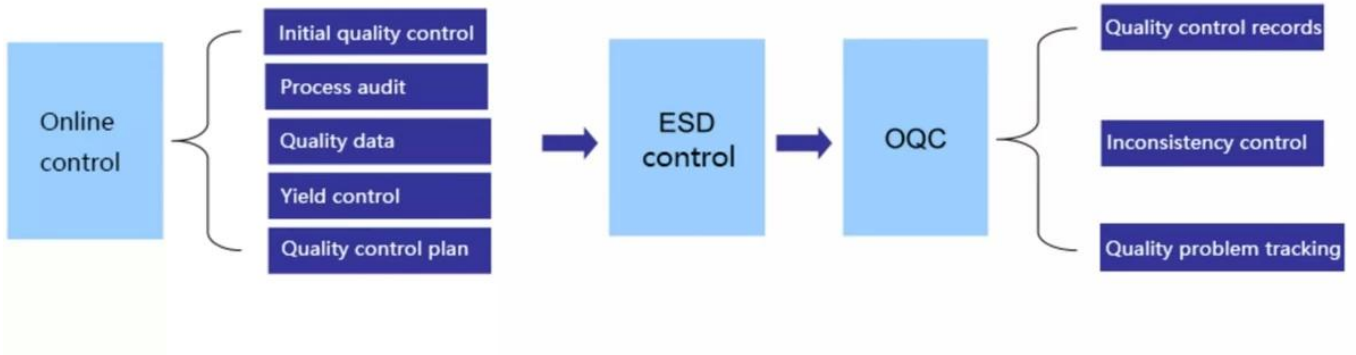
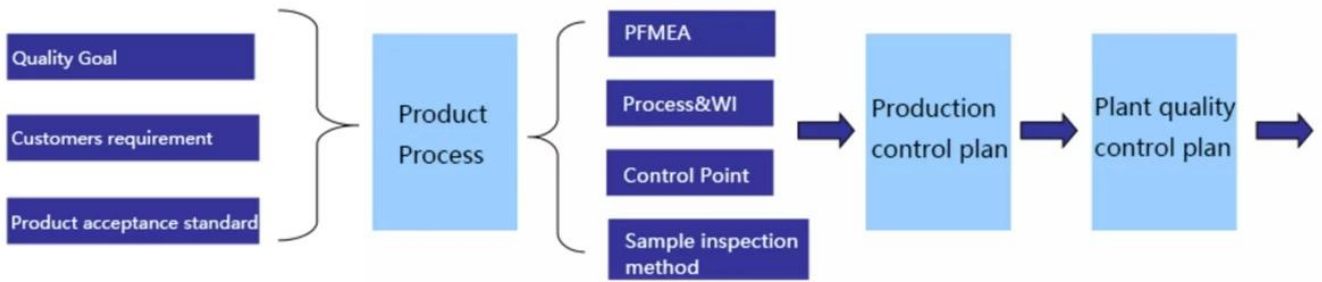
Описание продукта











Market Share

CONSUMER ELECTRONICS

AUTOMOTIVE ELECTRONICS

INDUSTRIAL CONTROL

INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL

OTHER

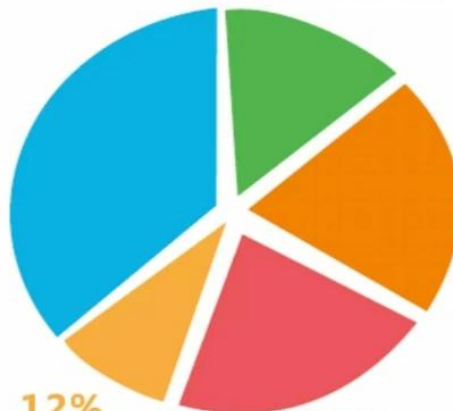


30%
CONSUMER ELECTRONICS



18%
INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL

20%
AUTOMOTIVE ELECTRONICS



12%
OTHER



20%
INDUSTRIAL CONTROL



Наша команда



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine

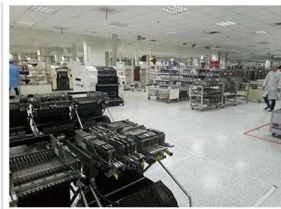


High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Сертификаты

CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 18118Q10347R05

We hereby certify that
O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED
 Credit No: 61691591-000-07-18-7
 Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES
 VOEUS BOAD CENTRAL HK
 Business Add: 1313, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang
 District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System**
 Which fulfils the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
 Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018
 Renewal date: April 22, 2019

This certificate is valid during: April 22, 2019 ~ February 26, 2021
 This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period


First supervision and audit	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	------------------------------	----------------

The certification implementation scope doesn't include those production stages which shall be covered by the relevant effective administrative provisions and qualification provisions regulated by the state. The effectiveness of this certificate shall be notified by annual surveillance audit of CICC. The certificate shall be valid also only together with the surveillance audit certificate. The initial issuance of this certificate can be searched at the portal of CICC: www.cicc.com.cn. Or the site of members: www.cicc.com.cn.






CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

质量管理体系认证证书

证书号: 18118Q10347R05

兹证明
诚领供应链(香港)有限公司
 统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7
 注册地址: 香港中環德輔道中 130-132 號大生銀行大廈 1205 室
 经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦 13 楼 1313




建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求

认证范围
 印刷线路板的销售

初次发证日期: 2018年02月27日
 换证日期: 2019年04月22日
 证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日
 在下列期限内, 未经 CICC 黏贴合格标贴, 本证书无效

第一次监审	第二次监审	贴标处
-------	-------	-----

本证书认证范围不包括未获得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围。本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效。本证书信息可在国家认监委网站: www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc.com.cn查询。




ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width			SS/ DS/ DSO	Max	Max			Meets UL796	C T	
	Min	Cond	Area		Solder	Flame	Class				
	Min	Edge			Thk			Oper			
mm(in)	mm(in)	mic(mil)	Diam	Limits	Temp	DSR	I				
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Возможности процесса

Возможности производства печатных плат

Количество слоев	1Слой-32Слой
Толщина готовой меди	1/3 - 12 унций
Мин. Ширина линии / внутренний интервал	3,0 мил / 3,0 мил
Мин. Ширина линии / внешний интервал	4,0 мил / 4,0 мил
Максимальное соотношение сторон	10: 1
Толщина доски	0,2 мм-5,0 мм
Максимальный размер панели (дюймы)	635 * 1500 мм
Минимальный размер просверленного отверстия	4мил
Допуск отверстий с отверстиями	+/- 3мил
Blind / Buried Vias (типы AII)	ДА
Через заливку (проводящий, непроводящий)	ДА
Базовый материал	FR-4, FR-4high Tg. Материал без галогенов, Rogers, алюминиевая основа,Полиимид, тяжелая медь
Отделка поверхности	HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, lmmersion silver,олово lmmersion, золотые пальцы, угольные чернила

Возможности производства SMT

Материал печатной платы	FR-4, СЕМ-1, СЕМ-3, плита на основе алюминия
Максимальный размер печатной платы	510x460 мм
Минимальный размер печатной платы	50x50 мм
Толщина печатной платы	0,5 мм-4,5 мм
Толщина доски	0,5-4 мм
Мин. Размер компонентов	0201
Компонент стандартного размера чипа	0603 и больше
Макс.высота компонента	15мм
Мин. Шаг	0,3 мм
Мин. Шаг мяча BGA	0,4 мм
Точность размещения	+/- 0,03 мм

Упаковка и доставка

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Вопросы-Ответы

1. Как O-Leading обеспечивает качество?

Наш высокий стандарт качества достигается следующим образом.

1.1 Процесс строго контролируется стандартами ISO 9001: 2008.

1.2 Широкое использование программного обеспечения для управления производственным процессом

1.3 Современное испытательное оборудование и инструменты. Например. Летающий зонд, рентгеновский контроль, AOI (автоматический оптический инспектор) и ICT (внутрисхемное тестирование).

1.4 Выделенная группа обеспечения качества с процессом анализа случаев отказа

1.5. Непрерывное обучение и обучение персонала

2. Как O-Leading поддерживает конкурентоспособность ваших цен?

За последнее десятилетие цены на многие виды сырья (например, медь, химикаты) выросли вдвое, утроили или в четыре раза; Китайская валюта юань выросла на 31% по сравнению с долларом США; И стоимость нашей рабочей силы также значительно выросла.

Однако O-Leading сохранила наши цены на прежнем уровне. Это полностью связано с нашими инновациями в снижении затрат, предотвращении потерь и повышении эффективности. Наши цены очень конкурентоспособны в отрасли при том же уровне качества.

Мы верим в беспроигрышное партнерство с нашими клиентами. Наше партнерство будет взаимовыгодным, если мы сможем предоставить вам крайнюю стоимость и качество.

3. Какие виды досок могут обрабатывать O-Leading?

Обычные платы FR4, с высоким TG и без галогенов, Rogers, Arlon, Telfon, платы на основе алюминия / меди, PI и т. Д.

4. Какие данные необходимы для производства печатных плат и печатных плат?

4.1 BOM (Bill of Materials) с позиционными обозначениями: описание компонента, название производителя и номер детали.

4.2 Файлы PCB Gerber.

4.3 Производственный чертеж печатной платы и сборочный чертеж печатной платы.

4.4 Процедуры испытаний.

4.5 Любые механические ограничения, например требования к высоте сборки.

5. Каков типичный технологический процесс для многослойной печатной платы?

Резка материала → Внутренняя сухая пленка → внутреннее травление → Внутренний AOI → Многослойная связка → Слои наложения Нажатие → Сверление →PTH → Покрытие панели → Внешняя сухая пленка → Узорчатое покрытие → Внешнее травление → Внешний AOI → Маска припоя → Метка компонента → Обработка поверхности → Маршрут → E / T → Визуальный осмотр.

6. Какое ключевое оборудование для производства HDI?

Список основного оборудования следующий: лазерный сверлильный станок, пресс, линия VCP, автоматический экспонирующий станок, LDI и т. Д.

Наше оборудование является лучшим в отрасли, лазерные сверлильные станки производства Mitsubishi и Hitachi, станки LDI производства Screen (Япония), автоматические экспонирующие машины также производства Hitachi, все они позволяют удовлетворить технические требования клиентов.

7. Сколько типов поверхностной обработки можно сделать с помощью свинцового грифеля?

O-the Leader имеет полный спектр отделки поверхности, такой как: ENIG, OSP, LF-HASL, золотое покрытие (мягкое / твердое), иммерсионное серебро, олово, серебряное покрытие, иммерсионное лужение, угольные чернила и т. Д. OSP, ENIG, OSP + ENIG, обычно используемые на HDI, обычно рекомендуется использовать клиент или OSP OSP + ENIG, если размер BGA PAD менее 0,3 мм.

8. Каковы ваши возможности для FPC? Может ли O-Leading также предоставлять услуги SMT?

O-Leading может изготавливать FPC от одного до восьми слоев, размер рабочей панели может достигать 2000 мм * 240 мм, подробности см. На странице «Возможности Flex».

Мы также предоставляем клиентам комплексное обслуживание SMT.

9. Какие основные факторы повлияют на цену печатной платы?

Материал;

Чистота поверхности;

Технологическая сложность;

Различные критерии качества;

Характеристики печатной платы;

Условия оплаты;

Разные страны-производители.

10. Каково определение понятий PCB, PWB и FPC и в чем разница?

PCB - сокращение от Printed Circuit Board;

PWB - сокращение от Printed Wire Board, то же самое, что и Printed Circuit Board;
FPC - это сокращение от гибкой печатной платы.

11. Какие факторы следует учитывать при выборе материала для печатной платы?

При выборе материала для печатной платы следует учитывать следующие факторы:

Значение Tg материала должно быть выше рабочей температуры;

Материал с низким КТР обладает хорошими показателями термической стабильности;

Хорошие характеристики термического сопротивления: Обычно требуется, чтобы печатные платы выдерживали 250 °C не менее 50 секунд.

Хорошая ровность; Принимая во внимание электрические свойства, на высокочастотной печатной плате используется материал с низкими потерями / высокой диэлектрической проницаемостью;

Подложка из полиимидного стекловолокна, используемая для гибких печатных плат;

Металлический сердечник используется, когда к продукту предъявляются строгие требования по отводу тепла.

12. В чем заключаются преимущества гибкой жесткой печатной платы O-Leading?

Жестко-гибкая печатная плата O-Leading имеет характеристики как FPC, так и печатной платы, поэтому ее можно использовать в некоторых специальных продуктах. Одна часть является гибкой, а другая - жесткой, это может помочь сэкономить внутреннее пространство продукта, уменьшить объем продукта и повысить производительность.

13. Как произвести расчет импеданса?

Система контроля импеданса выполняется с использованием некоторых тестовых образцов, SI6000 soft и оборудования CITS 500s от POLAR INSTRUMENTS.

Оборудование измеряет импеданс на типичном купоне конфигурации дорожки, для которого клиент дал нам определенное значение и допуск.